



SIP 第3期課題「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」
サブ課題B「データ基盤連携技術の確立」
個別テーマ(2)「我が国マテリアルデータ資産のネットワーク化」
2023年度採択課題一覧

No.	研究開発責任者 (代表研究開発機関)	採択課題名
1	金子 純一(国立大学法人 北海道大学)	ダイヤモンド半導体の飛躍的活用を支える高温動作電子部品の開発
2	齋藤 永宏(東海国立大学機構 名古屋大学)	ハイエントロピー材料の結晶構造データ・記述子データベースの開発